

拓荆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

股票名称：拓荆科技

股票代码：688072

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	海富通基金、淡水泉、泉果基金、华夏基金、重阳投资、朱雀基金、泰达宏利、泓澄投资、丹羿投资、星石投资、国金证券、富国基金、华商基金、人保养老、鹏扬基金、新华资产、广发基金、交银基金、光大证券
时间	2023年9月19日
地点	公司现场会议
公司接待人员姓名	证券事务代表：刘锡婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节主要内容：</p> <p>1. 公司展望 2023 年第三季度新签订单、营业收入情况及环比趋势如何？ 答：公司一直紧跟客户需求，与客户持续签订产品订单，并积极推进产品验证进度，具体新签订单及营业收入情况请关注公司后续公开披露信息。</p> <p>2. 公司产品从签订订单到交付的周期如何？ 答：公司产品从签订订单到交付的周期通常为 3-6 个月，同时，公司可以为客户提供定制化产品，并根据客户需求及时供给产品。</p> <p>3. 公司 PECVD、ALD 等成熟产品的市场占有率如何？ 答：公司产品已经进入国内 60 多条产线，公司 PECVD、ALD 等成熟产品量产规模持续扩大，但因无法获取晶圆制造厂实际需求情况，尚未具体统计产品的市场占有率。</p> <p>4. 公司预计 2023 年 ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜系列产品量产规模情况如何？ 答：公司 ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜系列产品是在公司 PECVD 设备量产后陆续推出的量产产品，目前在逐步扩大量产应用规模，2023 年该等产品的产量及销量情况请关注公司后续公开披露信息。</p>

5. 公司如何维持已量产的成熟产品及未来开发新产品的市场竞争力？

答：公司一直坚持自主创新，持续保持高强度的研发投入，不断优化设备产品的性能。一方面，公司持续提升现有量产产品的核心竞争力，同时，结合半导体行业的技术发展趋势及客户需求，提前布局开发新产品或新工艺，加速推进产品验证进度，及时为客户提供高质量的产品，以获得客户的认可。

6. 公司为什么布局研制混合键合设备？混合键合设备的原理是什么？公司该设备技术是否为自研技术？

答：随着半导体工艺技术的发展，芯片架构由 2D、2.5D 逐步向 3D 创新发展，支撑芯片架构发展的键合技术不断更新迭代，而混合键合技术具备实现更高带宽、更高功率、更高通信速度等优势特点，成为当前业界优选的解决方案。随着“后摩尔时代”的来临，以三维集成为代表的先进芯片架构成为半导体芯片技术发展的重要方向和路径，将直接拉动混合键合设备的市场需求量，未来键合设备具有较大的潜在市场需求和增长空间，因此，公司布局开发混合键合设备。公司研制的混合键合设备是在常温下通过永久键合工艺实现芯片或晶圆的堆叠，公司混合键合设备技术均为自主开发。

7. 公司在国内采购零部件的占比情况？是否有零部件提前备货？

答：公司已经建立了全球范围内的供应链资源，搭建了稳定的供应链结构，并采取多货源的供应商策略。公司结合需求预测、供货周期等情况合理规划采购体量及进度，部分部件会提前备货，以确保部件供给匹配机台生产需求。

8. 半导体行业人才紧张，公司如何吸引留住行业骨干人才？

答：公司已建立了较为完善的人才引进和培养体系，为员工提供具有竞争力的薪酬福利，并充分发挥股权激励机制的作用，增强公司人才团队的稳定性及凝聚力。

9. 公司未来产品研发布局规划情况？

答：公司将继续在高端半导体设备领域深耕，并围绕 CVD 领域做深做精，不断在细分领域拓展产品、工艺的覆盖面，扩大市场占有率，同时，积极推进混合键合设备的研发与产业化。